

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年4月3日(03.04.2025)

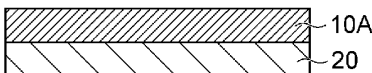


(10) 国際公開番号
WO 2025/070385 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) *C09J 11/08* (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01) *C09J 163/00* (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/033926
- (22) 国際出願日: 2024年9月24日(24.09.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-166182 2023年9月27日(27.09.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).
- (72) 発明者: 趙 雪(ZHAO Xue); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 谷口 紘平(TANIGUCHI Kohei); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 原田 雄太(HARADA Yuta); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiaki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

(54) Title: FILM ADHESIVE, DICING/DIE ATTACH FILM, SEMICONDUCTOR DEVICE, AND PRODUCTION METHOD FOR SAME

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、並びに半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: Provided is a film adhesive comprising metal particles, an epoxy resin, a phenolic resin, and an elastomer, wherein the content of the metal particles is not less than 80.0 mass% with respect to the mass of the film adhesive, the epoxy resin contains a first epoxy resin that is liquid at 25 ° C and a second epoxy resin that is solid at 25 ° C, and when the content of the metal particles is expressed as 100 mass parts, the content of the first epoxy resin is 4.0-5.5 mass parts.

(57) 要約: 金属粒子、エポキシ樹脂、フェノール樹脂及びエラストマーを含むフィルム状接着剤であって、金属粒子の含有量が、フィルム状接着剤の質量を基準として、80.0質量%以上であり、エポキシ樹脂が、25℃において液状である第一のエポキシ樹脂と、25℃において固形である第二のエポキシ樹脂とを含み、金属粒子の含有量を100質量部としたとき、第一のエポキシ樹脂の含有量が4.0~5.5質量部である、フィルム状接着剤。

[続葉有]

WO 2025/070385 A1

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）